

2008-2009年中国半导体材料行业研究咨询报告

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2008-2009年中国半导体材料行业研究咨询报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/yuanqijian/2796027960.html>

报告价格：电子版: 7000元 纸介版：7500元 电子和纸介版: 8000

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

【英文版价】 15000元【英文电子】 16000元【英文两版】 17000元

随着以消费者为导向的应用爆炸式增长，半导体产业受到了极大驱动。半导体制造与封装越来越多地引入各种新材料，这为半导体材料供应商带来了许多商机。预测2008年全球半导体产业将增长4%，而全球半导体材料市场将增长9%，达461亿美元。在区域市场部分,日本在雄厚的晶圆制造和封装市场基础下，2008年以22%的占有率成为全球最大的材料市场,而台湾在过去四年晶圆和封装产业强劲成长的带动下,则成为第二大半导体材料市场。此外,总括新加坡、马来西亚、菲律宾、其它东南亚国家,以及小型全球市场则排名第三大。而大家关注的中国市场,在产能陆续开出之后,成为全球成长最快的半导体材料市场。然而，目前我国半导体支撑材料业的发展很不平衡，与国际高科技产品相比较还存在一些差距。因此，国内半导体材料企业应该"苦练内功、夯实基础"，不断提高工艺水平，加强技术创新力度，让产品上档次，满足高端市场的需求。这样才不会忧虑国外厂商大举进入带来的激烈竞争，更不用担心国外先进技术带来的巨大冲击，反而可以吸引更多的大型厂商进入国内市场，形成一种良好的竞争机制与环境，促进半导体材料市场的健康发展以及国内电子信息产业企业的技术进步与产业升级。与半导体产业链上其他环节相比，国家对半导体材料产业的支持相对较弱，业界在不断呼吁，相关政策应尽快延伸到材料业。在消费电子与绿色能源需求的推动下，新型半导体材料将更多地在生产中得到应用，新材料的使用同时也是降低成本的需求。此外，新的工艺技术也会对材料提出新的要求。预计到2010年或2014年，硅材料的技术和产业发展将走向极限，第二代和第三代半导体技术和产业将成为研究和发展的重点。政府决策部门、半导体科研单位和企业现有的技术、市场和发展趋势面前应把握历史机遇，迎接挑战。本研究咨询报告在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家发改委、国家商务部、国家工业和信息化部、国务院发展研究中心、国家海关总署、中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、中国电子元件行业协会、国内外多种相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量资料。本报告对国内外半导体材料行业的发展状况进行了深入透彻地研究，对我国半导体材料主要市场发展情况、投资机会作了详尽分析。报告重点分析了下游半导体行业发展情况，报告还对国内重点半导体材料企业及未来半导体材料发展趋势进行了分析，是半导体材料及相关制造企业、投资部门、研究机构准确了解目前中国市场发展动态，把握半导体材料行业发展方向，为企业经营决策提供重要参考的依据。

报告目录 目录CONTENTS

第一部分 行业发展概述

第一章 半导体材料概述

1第一节 半导体材料的概述

1一、半导体材料的定义 1二、半导体材料的分类 2三、半导体材料的特点 3四、化合物半导体材料介绍 4

2第二节 半导体材料特性和制备

6一、半导体材料特性和参数 6二、半导体材料制备 7

2第二章 世界半导体材料市场分析

9第一节 世界总体市场概况

9一、全球半导体材料的进展分析 9二、全球半导体材料市场发展现状 11三、第二代半导体材料砷化镓发展概况 12四、第三代半导体材料GaN发展概况 13

2第二节

北美半导体材料发展分析	14一、北美半导体设备与材料市场
14二、美国新半导体材料开发分析	16三、美国道康宁在半导体材料方面的研究进展
17四、2011年美国半导体材料市场发展预测	19第三节 亚洲半导体材料发展
20一、日本半导体新材料分析	20二、韩国半导体材料产业分析
20三、台湾半导体材料市场分析	22第四节 世界半导体材料行业发展趋势
23一、世界半导体材料发展趋势	23二、2008年全球半导体材料市场分析
30三、2011年世界半导体封装材料发展预测	31第二部分
行业现状及主要产品发展分析第三章 中国半导体材料行业分析	33第一节 行业发展概况
33一、半导体材料的发展概况	33二、半导体封装材料行业分析
36三、半导体硅材料发展现状	44四、国内半导体材料创新发展分析
46五、半导体支撑材料发展瓶颈分析	49第二节 中国半导体材料进出口状况
53一、2008年半导体材料进口分析	53二、2008年半导体材料出口分析
55第三节 半导体材料技术发展分析	57一、新材料研发投入分析
58二、最大半导体材料市场分析	58三、新材料与新工艺需求分析
59四、半导体材料竞争无线应用领域	60五、SOI技术发展分析
64第四节 半导体材料技术动向及挑战	67一、铜导线材料
67二、硅绝缘材料	69三、低介电质材料
69四、高介电质、应变硅	70五、太阳能板
71六、无线射频	71七、发光二极管
72第四章 主要半导体材料发展分析	75第一节 硅晶体
75一、国内外多晶硅产业概况	75二、单晶硅和外延片发展概况
82三、中国硅晶体材料产业特点	84四、我国多晶硅产业发展现状分析
85五、2009-2010年多晶硅行业发展趋势	88第二节 砷化镓
90一、砷化镓产业发展概况	90二、砷化镓材料发展概况
95三、我国砷化镓产业链发展情况分析	97四、砷化镓产业需求分析
99第三节 GaN	100一、GaN材料的特性与应用
100二、GaN的应用前景	106三、GaN市场发展现状
106四、GaN产业市场投资前景	107第四节 碳化硅
109一、碳化硅概况	109二、碳化硅生产企业分析
110三、国内碳化硅晶体发展情况	113四、2008-2010年碳化硅市场发展趋势
115第五节 其他半导体材料	117一、非晶半导体材料概况
117二、宽禁带氮化镓材料发展概况	119三、可印式氧化物半导体材料技术发展
123第三部分 半导体行业分析第五章	半导体行业发展分析
131第一节 国内外半导体产业发展情况	131一、国内外半导体产业发展概况
131二、中国内地半导体产业发展环境分析	135三、2008年全球半导体行业发展态势分析
144四、半导体企业竞争策略	157五、2008年奥运会后的世界半导体市场
159第二节 半导体市场发展预测	162一、2008年中国半导体市场增长预测
162二、2009年半导体产业发展预测	164三、2008-2010年半导体产业预测
165第六章 主要半导体市场分析	168第一节 LED产业发展
168一、全球LED产业发展概况	168二、中国LED产业发展概况
192三、我国半导体照明市场应用情况	206四、2008年LED产业资源整合分析

211五、2008-2010年中国LED产业发展预测	214第二节	电子元器件市场
217一、我国电子元器件产业发展前景分析	217二、	电子元件产业升级分析
221三、2008年电子元器件收入利润分析	224四、	2008年电子元器件市场渠道供应趋势分析
225五、2010年电子元器件市场预测	232第三节	集成电路
232一、2008年半导体集成电路产量分析	232二、	2008年中国集成电路市场运行分析
238三、2010年集成电路产业的总体发展趋势	242四、	2011年我国集成电路市场规模预测
243五、未来集成电路技术发展趋势	244第四节	半导体分立器件
246一、2008年半导体分立器件产量分析	246二、	2008年半导体器件进出口分析
253三、2008年半导体分立器件市场发展态势	254四、	2008年半导体分立器件市场预测
254第五节	其他半导体市场	258一、
258二、IC光罩市场发展概况	259第四部分	主要厂商分析
261第一节	有研半导体材料股份有限公司	261一、
261二、	公司概况	261二、
261三、	2008年公司经营情况	263三、
263三、	2008年公司动态	269第二节
269第二节	天津中环半导体股份有限公司	271一、
271一、	公司概况	271二、
271二、	2008年公司经营情况	272三、
272三、	2008年公司动态	278第三节
278第三节	峨嵋半导体材料厂	281一、
281一、	公司概况	281二、
281二、	公司发展成就	282第四节
282第四节	四川新光硅业科技有限责任公司	286一、
286一、	公司概况	286二、
286二、	2008年公司动态	288第五节
288第五节	洛阳中硅高科技有限公司	288一、
288一、	公司概况	288二、
288二、	公司技术研发分析	290第六节
290第六节	宁波立立电子股份有限公司	291一、
291一、	公司概况	291二、
291二、	公司产品及技术研发	292三、
292三、	2008年公司动态	293第七节
293第七节	宁波康强电子股份有限公司	294一、
294一、	公司概况	294二、
294二、	2008年公司经营情况	295第八节
295第八节	南京国盛电子有限公司	298一、
298一、	公司概况	298二、
298二、	工艺技术与产品	299第五部分
299第五部分	行业发展趋势及投资分析	第八章
第八章	半导体材料发展趋势	301第一节
301第一节	半导体材料发展预测	301一、
301一、	2008-2009年全球半导体材料市场成长率预测	301二、
301二、	2009-2010年化合物半导体材料市场预测	304三、
304三、	2010年中国半导体材料产业发展前景	304四、
304四、	2010年半导体材料销售额预测	305五、
305五、	未来半导体材料发展趋势	308第二节
308第二节	主要半导体材料的发展趋势	309一、
309一、	硅材料	309二、
309二、	GaAs和InP单晶材料	310三、
310三、	半导体超晶格、量子阱材料	310四、
310四、	一维量子线、零维量子点半导体微结构材料	313五、
313五、	宽带隙半导体材料	314六、
314六、	光子晶体	316七、
316七、	量子比特构建与材料	316第九章
316第九章	半导体材料投资及建议分析	318第一节
318第一节	半导体材料投资市场分析	318一、
318一、	国内企业投资多晶硅形势分析	318二、
318二、	2008年全球半导体投资市场分析	320三、
320三、	半导体产业投资模式变革分析	321四、
321四、	半导体领域风险投资困境分析	324五、
324五、	半导体新材料表征面临的挑战	330第二节
330第二节	2008年中国半导体行业投资分析	332一、
332一、	2008年中国半导体投资风险	332二、
332二、	2008年中国半导体业机会	332三、
332三、	2008-2009年中国半导体投资预测	333第三节
333第三节	发展我国半导体材料的建议	334一、
334一、	硅单晶和外延材料	334二、
334二、	GaAs及其有关化合物半导体单晶材料发展建议	

334三、发展超晶格、零维半导体微结构材料建议

- 334图表目录图表：元素半导体的性质与结构
- 4图表： - 化合物半导体的性质
- 5图表： - 化合物半导体的性质
- 5图表：部分二元化合物半导体的性质
- 5图表：CZT薄膜的能隙 E_g 与组分的关系
- 6图表：半导体用材料的定义及范围
- 9图表：2006-2009年全球电子级硅片总消耗量预测
- 10图表：2006-2008年管芯制造材料预测
- 11图表：2005年全球半导体材料市场规模
- 11图表：2008-2009年全球半导体材料市场规模预测
- 15图表：2000-2007年全球Fab产能分布的变化
- 23图表：2007年半导体材料市场分布统计
- 24图表：High-k/metalgate材料技术的演进发展
- 25图表：Dualmetal与Dualhigh-k的比较
- 26图表：藉由电极矩改变Gate的功函数
- 28图表：在金属闸极中添加不纯物
- 28图表：主要半导体材料的比较
- 34图表：半导体材料的主要用途
- 35图表：2001-2005年中国半导体封装材料市场规模及增长
- 36图表：2005年中国半导体封装材料市场结构
- 37图表：2005年国内半导体引线框架制造企业产能分布及市场份额
- 39图表：2005年国内金丝生产企业市场份额
- 40图表：现代微电子工业对硅片关键参数的要求
- 46图表：2008年1月全国半导体器件和已装配的压电晶体进口分析
- 53图表：2008年2月全国半导体器件和已装配的压电晶体进口分析
- 53图表：2008年3月全国半导体器件和已装配的压电晶体进口分析
- 53图表：2008年1季度全国半导体器件和已装配的压电晶体进口分析
- 53图表：2008年4月全国半导体器件和已装配的压电晶体进口分析
- 54图表：2008年5月全国半导体器件和已装配的压电晶体进口分析
- 54图表：2008年6月全国半导体器件和已装配的压电晶体进口分析
- 54图表：2008年2季度全国半导体器件和已装配的压电晶体进口分析
- 54图表：2008年7月全国半导体器件和已装配的压电晶体进口分析
- 54图表：2008年8月全国半导体器件和已装配的压电晶体进口分析
- 55图表：2008年1-8月全国半导体器件和已装配的压电晶体进口分析
- 55图表：2008年1月全国半导体器件和已装配的压电晶体出口分析
- 55图表：2008年2月全国半导体器件和已装配的压电晶体出口分析
- 55图表：2008年3月全国半导体器件和已装配的压电晶体出口分析
- 55图表：2008年1季度全国半导体器件和已装配的压电晶体出口分析
- 56图表：2008年4月全国半导体器件和已装配的压电晶体出口分析
- 56图表：2008年5月全国半导体器件和已装配的压电晶体出口分析
- 56图表：2008年6月全国半导体器件和已装配的压电晶体出口分析
- 56图表：2008年2季度全国半导体器件和已装配的压电晶体出口分析

- 56图表：2008年7月全国半导体器件和已装配的压电晶体出口分析
- 57图表：2008年8月全国半导体器件和已装配的压电晶体出口分析
- 57图表：2008年1-8月全国半导体器件和已装配的压电晶体出口分析
- 57图表：1998年IBM公司使用自有的CMOS7S制程技术来产制的芯片
- 68图表：High-k材料与SiO₂材料比较
- 70图表：德国西门子公司用单晶硅材料制成的太阳能基板
- 71图表：常见的LED发光材料
- 72图表：红光LED的照射使植物（农作物）增长图
- 73图表：2002-2010年全球及中国太阳能级多晶硅需求量统计及预测
- 76图表：2005-2010年全球太阳能电池产量统计与预测
- 77图表：2005年世界主要多晶硅生产企业产能及生产情况
- 78图表：2003-2006年国内多晶硅生产产量趋势图
- 79图表：多晶硅质量指标
- 81图表：砷化镓与硅的组件特性比较
- 90图表：砷化镓微波三种元件结构之特性的比较
- 91图表：砷化镓产业上下游关联图
- 93图表：砷化镓微波组件的商业运用
- 94图表：GaAs单晶生产方法比较
- 95图表：世界GaAs单晶主要生产厂家的分布
- 96图表：钐矿GaN和闪锌矿GaN的特性
- 100图表：双气流MOCVD生长GaN装置
- 103图表：GaN基器件与GaAs及SiC器件的性能比较
- 104图表：以发光效率为标志的LED发展历程
- 104图表：不同碳化硅类型情况简介
- 109图表：碳化硅晶片生产及应用前景情况
- 110图表：碳化硅晶片生产企业情况
- 111图表：碳化硅晶片生产工艺
- 112图表：SiC器件的研究概表
- 120图表：非晶型氧化镓镓锌材料系统组成比例(右)与电子迁移率(左)
- 124图表：五种基本的印制方式
- 125图表：典型传统印制技术应用之基材种类与印制材料及其最小线宽
- 126图表：软式微影技术的组件制作流程
- 127图表：高分辨率软式微影技术压印头印制250nm×250nm方柱图
- 128图表：由100 μm玻璃背板及30 μm聚合物双层模块成具有270nm图案之压印头实例
- 128图表：传统印制技术与软式微影技术相对应的比较
- 129图表：全球半导体应用领域分布
- 131图表：2005年全球半导体分类产品销售收入
- 132图表：2006年排名前十位的半导体公司
- 132图表：2003-2005年半导体市场向亚太地区转移
- 133图表：我国集成电路生产线统计
- 138图表：2006年我国内地IC封装测试企业收入前十名
- 139图表：2008年6月全球半导体销售情况
- 145图表：2000-2008年欧洲半导体月度销售额
- 145图表：2000-2008年欧洲半导体各月销售额同比增长率
- 146图表：2007年7月-2008年7月全球半导体销售额
- 146图表：2007年7月-2008年7月全球半导体销售额同比和环比变化率
- 147图表：2007年7月-2008年7月欧洲半导体销售额
- 147图表：2007年7月-2008年7月欧洲半导体销售额同比和环比变化率
- 147图表：2007年7月-2008年7月美国半导体销售额

- 148图表：2007年7月-2008年7月美国半导体销售额同比和环比变化率
- 148图表：2007年7月-2008年7月日本半导体销售额
- 149图表：2007年7月-2008年7月日本半导体销售额同比和环比变化率
- 149图表：2007年7月-2008年7月亚太地区半导体销售额
- 149图表：2007年7月-2008年7月亚太地区半导体销售额同比和环比变化率
- 150图表：2008年3-7月中国半导体销售额
- 150图表：2007年8月-2008年8月全球半导体销售额
- 151图表：2007年8月-2008年8月全球半导体销售额同比和环比变化率
- 151图表：2007年8月-2008年8月欧洲半导体销售额
- 152图表：2007年8月-2008年8月欧洲半导体销售额同比和环比变化率
- 152图表：2007年8月-2008年8月美国半导体销售额
- 152图表：2007年8月-2008年8月美国半导体销售额同比和环比变化率
- 153图表：2007年8月-2008年8月日本半导体销售额
- 153图表：2007年8月-2008年8月日本半导体销售额同比和环比变化率
- 153图表：2007年8月-2008年8月亚太地区半导体销售额
- 154图表：2007年8月-2008年8月亚太地区半导体销售额同比和环比变化率
- 154图表：2008年3-8月中国半导体销售额 155图表：2008年上半年半导体行业销售额排名
- 156图表：2008年上半年半导体行业销售额增长率排名
- 156图表：2008-2012年中国半导体市场营业收入预测
- 162图表：2008-2012年在中国设计的主要电子产品的营业收入预测
- 163图表：全球主要LED业者概况
- 169图表：2011年全球LED市场成长预测
- 169图表：全球高亮芯片主要应用领域分布（按销售额统计）
- 170图表：全球高亮芯片主要应用领域分布（按销售量统计）
- 170图表：全球主要LED领先厂商
- 175图表：2006年全球主要LED大厂营运收入
- 175图表：LED产业链投资规模估算
- 176图表：国际半导体照明专利状况对比
- 176图表：全球七大LED巨头专利数分布
- 176图表：LED发光效率演进
- 185图表：各种照明技术发光效率与光电转换效率变化
- 186图表：LED基本分类与应用市场
- 188图表：传统亮度与高亮度LED产品应用市场
- 189图表：2006-2010年全球手机出货量预测
- 190图表：各种手机用面板技术比较
- 191图表：2006-2010LED背光模组出货趋势
- 191图表：2003-2009年全球照明市场规模及预测
- 191图表：2004-2006年蓝光LED芯片价格变化
- 192图表：LED应用市场发展路线图
- 192图表：2006年国内LED芯片市场分布图
- 194图表：2008年全球LED应用领域分布情况
- 212图表：国内主要LED产业基地及其核心企业
- 213图表：2003-2010年国内GaN芯片产能发展预测

213图表：国内LED产品的应用领域分布 213图表：我国半导体照明产业中下游优劣势比较

214图表：2008年的中国地区电子元器件市场业务平均增长幅度预测

225图表：2008年元器件原厂的平均交货期有所缩短

228图表：2008年电子元器件独立分销商开始将重点转向服务的提供

230图表：电子元器件分销商提供小批量供应时所面临的主要挑战

231图表：2008年2-8月半导体集成电路全国产量合计

232图表：2008年2-8月半导体集成电路北京市产量合计

233图表：2008年2-8月半导体集成电路天津市产量合计

233图表：2008年2-8月半导体集成电路河北省产量合计

233图表：2008年2-8月半导体集成电路辽宁省产量合计

234图表：2008年2-8月半导体集成电路上海市产量合计

234图表：2008年2-8月半导体集成电路江苏省产量合计

234图表：2008年2-8月半导体集成电路浙江省产量合计

235图表：2008年2-8月半导体集成电路福建省产量合计

235图表：2008年2-8月半导体集成电路山东省产量合计

235图表：2008年2-8月半导体集成电路河南省产量合计

236图表：2008年2-8月半导体集成电路湖北省产量合计

236图表：2008年2-8月半导体集成电路湖南省产量合计

236图表：2008年2-8月半导体集成电路广东省产量合计

237图表：2008年2-8月半导体集成电路重庆市产量合计

237图表：2008年2-8月半导体集成电路四川省产量合计

237图表：2008年2-8月半导体集成电路贵州省产量合计

238图表：2008年2-8月半导体集成电路甘肃省产量合计

238图表：2004-2008年上半年中国集成电路市场销售额规模及增长率

239图表：2008年上半年中国集成电路市场各应用领域增长率

240图表：2008年上半年中国集成电路市场应用结构

240图表：2008年上半年中国集成电路市场产品结构

241图表：2008年2-8月半导体分立器件全国产量合计

246图表：2008年2-8月半导体分立器件北京市产量合计

246图表：2008年2-8月半导体分立器件天津市产量合计

247图表：2008年2-8月半导体分立器件河北省产量合计

247图表：2008年2-8月半导体分立器件辽宁省产量合计

247图表：2008年2-8月半导体分立器件吉林省产量合计

248图表：2008年2-8月半导体分立器件黑龙江产量合计

248图表：2008年2-8月半导体分立器件上海市产量合计

- 248图表：2008年2-8月半导体分立器件江苏省产量合计
- 249图表：2008年2-8月半导体分立器件浙江省产量合计
- 249图表：2008年2-8月半导体分立器件安徽省产量合计
- 249图表：2008年2-8月半导体分立器件福建省产量合计
- 250图表：2008年2-8月半导体分立器件江西省产量合计
- 250图表：2008年2-8月半导体分立器件山东省产量合计
- 250图表：2008年2-8月半导体分立器件河南省产量合计
- 251图表：2008年2-8月半导体分立器件湖北省产量合计
- 251图表：2008年2-8月半导体分立器件湖南省产量合计
- 251图表：2008年2-8月半导体分立器件广东省产量合计
- 252图表：2008年2-8月半导体分立器件广西区产量合计
- 252图表：2008年2-8月半导体分立器件四川省产量合计
- 252图表：2008年2-8月半导体分立器件贵州省产量合计
- 253图表：2008年2-8月半导体分立器件陕西省产量合计
- 253图表：2008年全球分立器件终端产品市场预测
- 255图表：2008年我国分立器件市场按产品结构细分预测
- 255图表：半导体气体与化学品技术发展蓝图
- 259图表：有研半导体材料股份有限公司200mm硅抛光片规格
- 262图表：有研半导体材料股份有限公司150mm硅抛光片规格
- 262图表：2008年2季度有研半导体材料股份有限公司主营构成表
- 264图表：2007-2008年有研半导体材料股份有限公司每股指标
- 264图表：2007-2008年有研半导体材料股份有限公司获利能力表
- 264图表：2007-2008年有研半导体材料股份有限公司经营能力表
- 265图表：2007-2008年有研半导体材料股份有限公司偿债能力表
- 265图表：2007-2008年有研半导体材料股份有限公司资本结构表
- 265图表：2007-2008年有研半导体材料股份有限公司发展能力表
- 265图表：2007-2008年有研半导体材料股份有限公司现金流量分析表
- 266图表：2007-2008年有研半导体材料股份有限公司利润分配表
- 266图表：2008-2010年有研半导体材料股份有限公司资产负债表
- 267图表：2008-2010年有研半导体材料股份有限公司现金流量表
- 268图表：2008-2010年有研半导体材料股份有限公司利润表
- 268图表：2008-2010年有研半导体材料股份有限公司财务指标
- 269图表：天津中环半导体股份有限公司产品销售市场
- 271图表：2008年上半年天津中环半导体股份有限公司收入情况
- 273图表：2008年2季度天津中环半导体股份有限公司主营构成表

- 274图表：2007-2008年天津中环半导体股份有限公司每股指标
274图表：2007-2008年天津中环半导体股份有限公司获利能力表
274图表：2007-2008年天津中环半导体股份有限公司经营能力表
275图表：2007-2008年天津中环半导体股份有限公司偿债能力表
275图表：2007-2008年天津中环半导体股份有限公司资本结构表
275图表：2007-2008年天津中环半导体股份有限公司发展能力表
275图表：2007-2008年天津中环半导体股份有限公司现金流量分析表
276图表：2007-2008年天津中环半导体股份有限公司利润分配表
276图表：2006-2009年天津中环半导体股份有限公司项目进度
277图表：2008-2009年天津中环半导体股份有限公司利润表
277图表：2008-2010年天津中环半导体股份有限公司基本财务状况
278图表：2008年上半年天津中环半导体股份有限公司分业务情况
279图表：2008年上半年天津中环半导体股份有限公司各项业务的经营情况
280图表：2008年天津中环半导体股份有限公司业绩越来越多的依赖单晶硅
280图表：天津中环半导体股份有限公司未来区熔单晶硅业务增长敏感性分析
281图表：新光硅业公司股东及持股比例
287图表：立立电子抛光片产品规格
292图表：立立电子外延片产品规格
293图表：2008年2季度宁波康强电子股份有限公司主营构成表
295图表：2007-2008年宁波康强电子股份有限公司每股指标
295图表：2007-2008年宁波康强电子股份有限公司获利能力表
296图表：2007-2008年宁波康强电子股份有限公司经营能力表
296图表：2007-2008年宁波康强电子股份有限公司偿债能力表
296图表：2007-2008年宁波康强电子股份有限公司资本结构表
296图表：2007-2008年宁波康强电子股份有限公司发展能力表
297图表：2007-2008年宁波康强电子股份有限公司现金流量分析表
297图表：2007-2008年宁波康强电子股份有限公司利润分配表
297图表：2008年全球半导体材料市场规模
302图表：中国半导体材料需求量
305图表：2005-2006年我国多晶硅企业筹建、新建、扩建情况 318略.....

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/yuanqijian/2796027960.html>